

2025年3月期 第2四半期 決算説明資料

2024年11月6日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。



当社グループの事業セグメント

エレクトロニクス事業 (エレキ事業)

プリント基板(PCB)用部材を始めとする
電子部品用化学品部材の開発・製造販売
及び仕入販売



医療・医薬品事業 (医薬事業)

医療用医薬品の製造販売・製造受託、
歯科技工物の製造販売



ICT&S事業

ICT事業、ファインケミカル事業、
エネルギー事業及び食糧事業等



2025年3月期 第2四半期 トピックス

エレクトロニクス事業

- 売上高は、累計YoYで23%増加 QoQで2%減少
〈累計YoYに関する要因〉
 - 円安に推移したことにより業績にプラスの影響
期中平均為替レート：当期1米ドル152.3円、前年同期1米ドル141.3円
 - PKG : メモリ向け製品を中心に需要の回復がみられ、販売数量増加
 - リジッド：ディスプレイ関連部材（白色DF）の販売数量が増加
車載関連、スマートフォン関連部材の販売数量が増加
- 〈QoQに関する要因〉
 - 円高に推移したことにより業績にマイナスの影響
期中平均為替レート：当期1米ドル152.3円、当期第1四半期1米ドル156.5円
 - リジッド：ディスプレイ関連部材（白色DF）の販売数量が減少
 - PKG : 第1四半期と同程度の販売数量を維持

医薬事業

- 売上高は、累計YoYで3%増加 QoQで17%減少
〈累計YoYに関する要因〉
 - リックの連結子会社化による増加
 - アルツハイマー型認知症治療剤「レミニール®」の製造販売承認の承継による増加
 - 他社同効薬の供給不足による需要増加、鎮咳去痰薬への需要増加
- 〈QoQに関する要因〉
 - 製造受託事業におけるプロダクトミックスの変化による減少

全社

- 2025年3月期の業績予想修正
エレクトロニクス事業において2024年8月1日開示の業績予想を上回る見込みとなったため、エレクトロニクス事業の上半期業績予想を実績値に更新する修正を実施。下半期は据え置き。

連結業績

	①	②	②-①	(②-①)÷①	③	②÷③	④	②÷④
単位:百万円	2024年3月期 上半期 実績	2025年3月期 上半期 実績	前年 同期比	増減率	2025年3月期 上半期 業績予想 (8月1日発表)	進捗率	2025年3月期 通期 業績予想 (8月1日発表)	進捗率
売上高	51,107	59,899	8,792	17%	59,400	101%	116,100	52%
営業利益	9,089	12,430	3,341	37%	11,700	106%	20,600	60%
経常利益	8,651	12,418	3,767	44%	11,400	109%	20,000	62%
親会社株主に帰属 する当期純利益	6,232	9,209	2,977	48%	8,000	115%	13,800	67%
円・USDレート	141.3	152.3	11.0		*1		*2	
EBITDA	13,464	16,986	3,521	26%	16,200	105%	30,100	56%
営業利益率	18%	21%			20%		18%	
EBITDA マージン	26%	28%			27%		26%	

*1 円・USDレート: 2025年3月期第1四半期 実績 156.5円、第2四半期 期初業績予想据え置き 145.0円

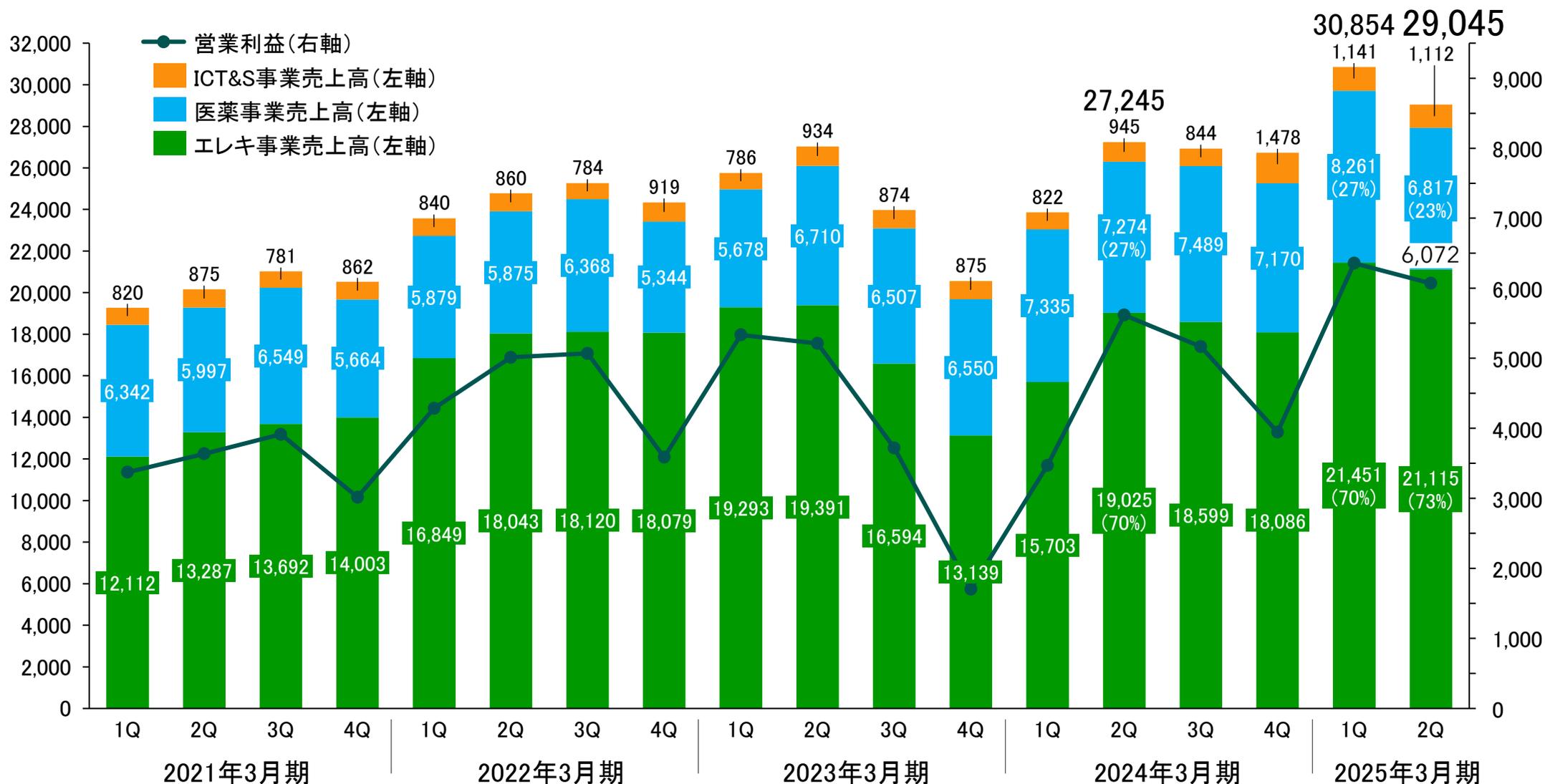
*2 円・USDレート: 2025年3月期第1四半期 実績 156.5円、
2025年3月期第2四半期～第4四半期 期初業績予想据え置き 145.0円

セグメント別業績(売上高・営業利益・EBITDA)

		①	②	②-①	(②-①)÷①	③	②÷③	④	②÷④
		2024年 3月期 上半期 実績	2025年 3月期 上半期 実績	前年 同期比	増減率	2025年 3月期 上半期 業績予想 (8月1日発表)	進捗率	2025年 3月期 通期 業績予想 (8月1日発表)	進捗率
単位:百万円									
エレクトロニクス事業	売上高	34,729	42,567	7,837	23%	41,000	104%	78,700	54%
	営業利益	7,702	12,045	4,343	56%	11,000	110%	19,700	61%
	営業利益率	22%	28%			27%		25%	
	EBITDA	9,011	13,772	4,760	53%	12,700	108%	23,300	59%
	EBITDAマージン	26%	32%			31%		30%	
医薬事業	売上高	14,609	15,078	469	3%	16,000	94%	32,500	46%
	営業利益	1,701	931	△770	△45%	1,400	67%	2,200	42%
	営業利益率	12%	6%			9%		7%	
	EBITDA	4,343	3,296	△1,046	△24%	3,900	85%	7,300	45%
	EBITDAマージン	30%	22%			24%		22%	
ICT&S事業	売上高	1,768	2,254	485	28%	-	-	-	-
	営業利益	74	138	64	86%	-	-	-	-
	営業利益率	4%	6%			-	-	-	-
全社費用	営業損益	△389	△685	△296		-	-	-	-

四半期別推移(売上高・営業利益)

単位:百万円



BSの概況

BS前期比較

単位:百万円

	24/3末	24/9末	増減		24/3末	24/9末	増減
現金及び預金	58,583	53,344	△5,238	支払手形及び買掛金	8,795	9,428	632
売上債権* ¹	28,352	28,458	106	短期借入金* ³	43,588	25,018	△18,569
棚卸資産* ²	17,166	20,319	3,152	長期借入金	43,134	52,458	9,324
上記以外	5,552	2,921	△2,630	上記以外	16,835	13,852	△2,982
流動資産合計	109,655	105,044	△4,610	負債合計	112,353	100,758	△11,595
有形固定資産	68,852	68,681	△171	株主資本	89,925	97,050	7,125
無形固定資産	25,804	24,325	△1,478	その他の包括利益 累計額	10,469	9,010	△1,458
投資その他の資産	8,439	8,771	331	非支配株主持分	4	4	0
固定資産合計	103,096	101,778	△1,317	純資産合計	100,398	106,065	5,666
資産合計	212,751	206,823	△5,928	負債純資産合計	212,751	206,823	△5,928
				自己資本比率	47.2%	51.3%	4.1%

*1 売上債権:受取手形+売掛金+契約資産

*2 棚卸資産:商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品

*3 短期借入金:短期借入金+1年内返済予定の長期借入金

2025年3月期 通期業績予想修正

- ✓ エレキ事業において2024年8月1日開示の業績予想を上回る見込みとなったため、通期業績予想を修正しました。
- ✓ 第3四半期以降の業績予想は2024年8月1日に開示した業績予想を据え置き、エレキ事業の上半期業績予想を実績値に更新し連結業績予想を修正しました。

単位:百万円		2025年3月期 通期業績予想 (8月1日発表)*1		2025年3月期 通期業績予想 (11月6日発表)*2		増減比	
		金額	利益率	金額	利益率	金額	率
連結	売上高	116,100		117,700		+1,600	+1%
	営業利益	20,600	18%	21,700	18%	+1,100	+5%
	経常利益	20,000	17%	21,100	18%	+1,100	+6%
	親会社株主に帰属する当期純利益	13,800	12%	14,500	12%	+700	+5%
	EBITDA	30,100	26%	31,200	27%	+1,100	+4%
エレキ 事業	売上高	78,700		80,300		+1,600	+2%
	営業利益	19,700	25%	20,800	26%	+1,100	+6%
	EBITDA	23,300	30%	24,400	30%	+1,100	+5%
医薬 事業	売上高	32,500		32,500		-	-
	営業利益	2,200	7%	2,200	7%	-	-
	EBITDA	7,300	22%	7,300	22%	-	-

*1 円・USDレート: 2025年3月期第1四半期 実績 156.5円

2025年3月期第2四半期～第4四半期 期初業績予想据え置き 145.0円

*2 円・USDレート: 2025年3月期上半期 実績 152.3円、2025年3月期下半期 期初業績予想据え置き 145.0円

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

エレクトロニクス事業

エレクトロニクス事業 用語説明

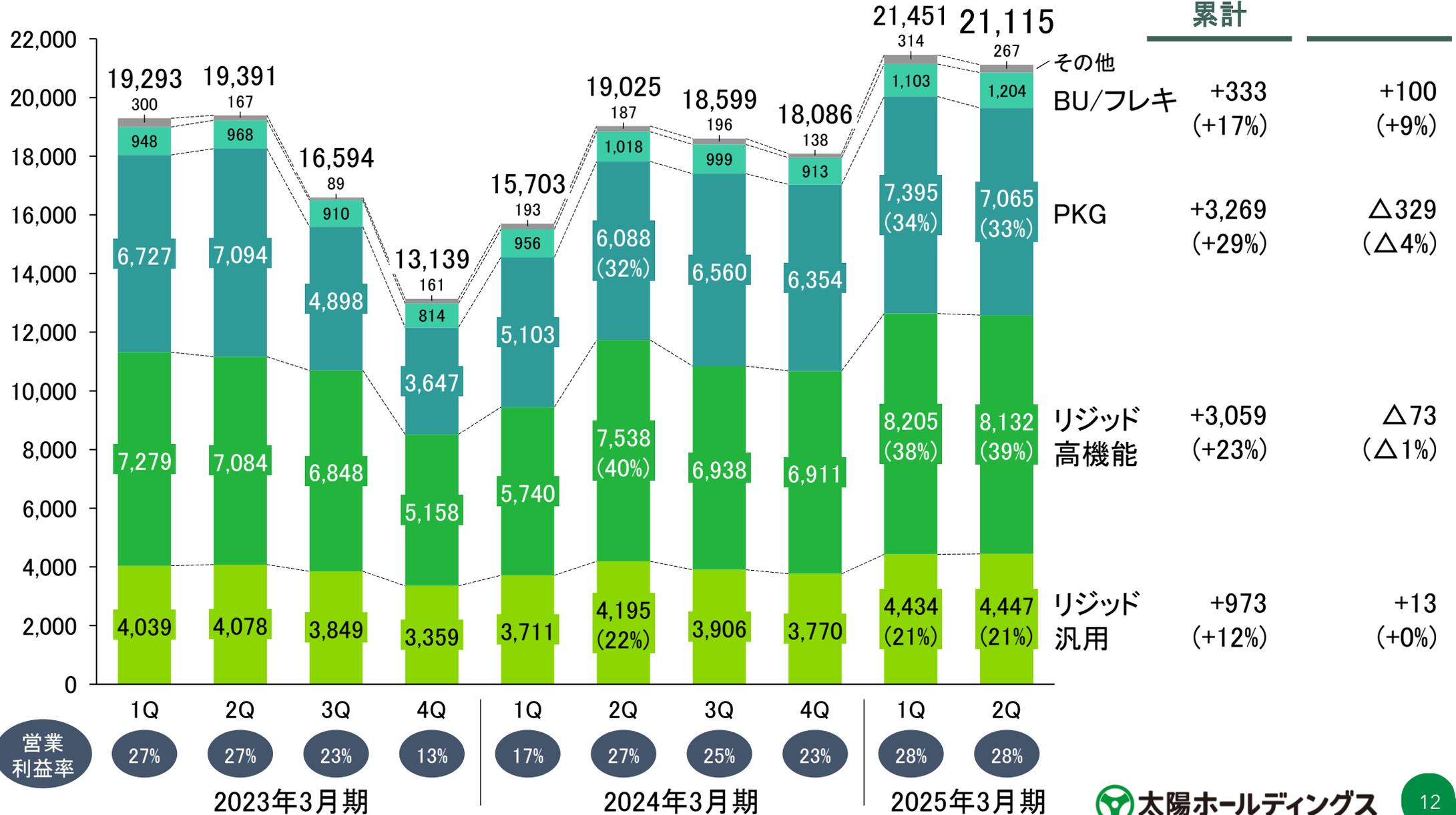
用語	内容
PCB (Printed Circuit Board)	プリント基板
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト(レジストインキ)
PKG (Package)	半導体パッケージ
DF (Dry Film)	ドライフィルム
BU (Build-up)	ビルドアップ

エレクトロニクス事業 製品分類

分野	分類		性状	用途
PCB用 絶縁材料	リジッド	汎用品	液状	表層保護・絶縁用SR材料 マーキング・エッチング・めっき用材料 電子機器用材料 等
		高機能品	液状／DF	
	PKG		液状／DF	
	フレキ		液状／DF	
	BU		液状／DF	
その他 関連商材	その他		液状／DF	導電性ペースト 等

エレクトロニクス事業 製品別売上高

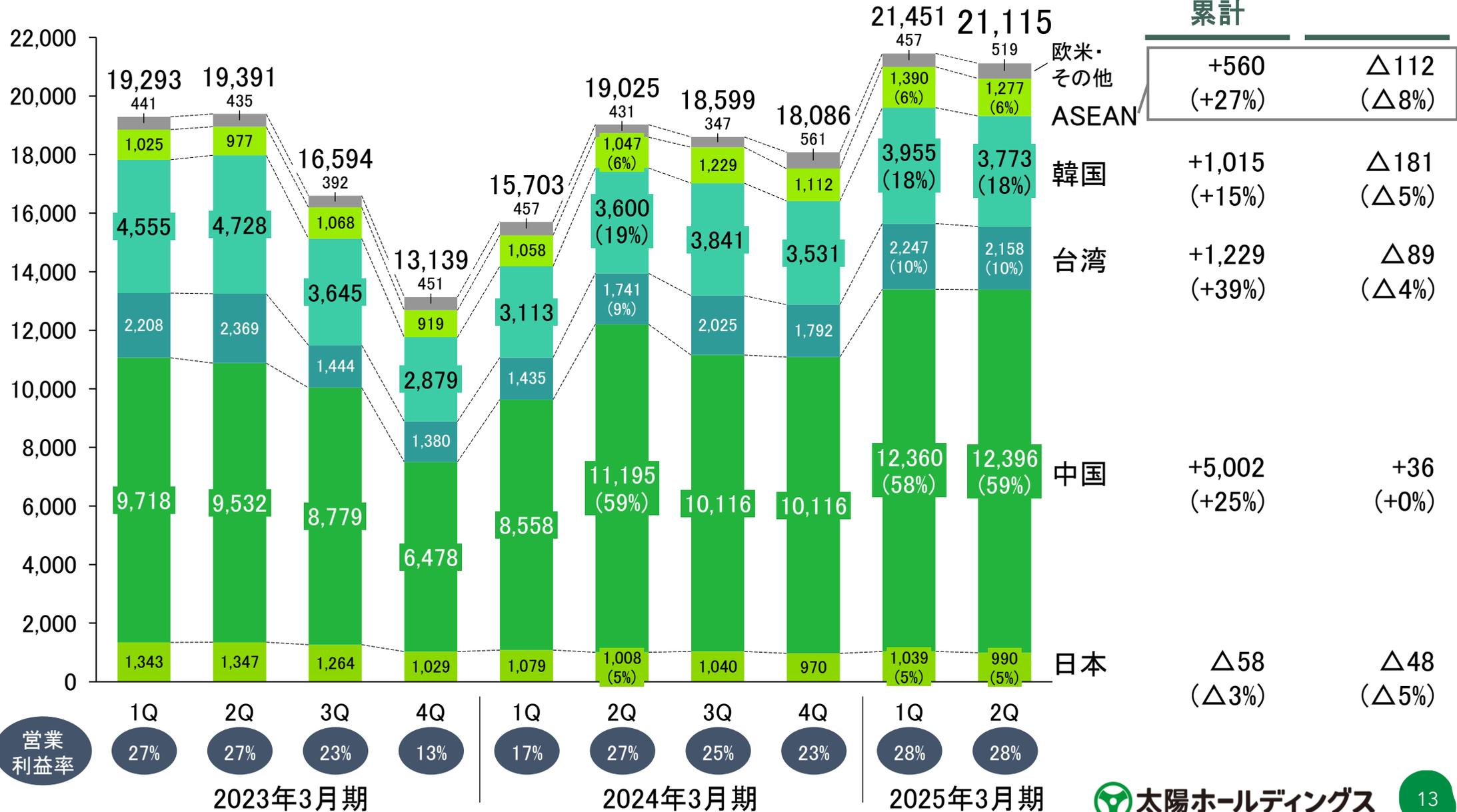
単位: 百万円



営業利益率

エレクトロニクス事業 販売地域別売上高

単位：百万円



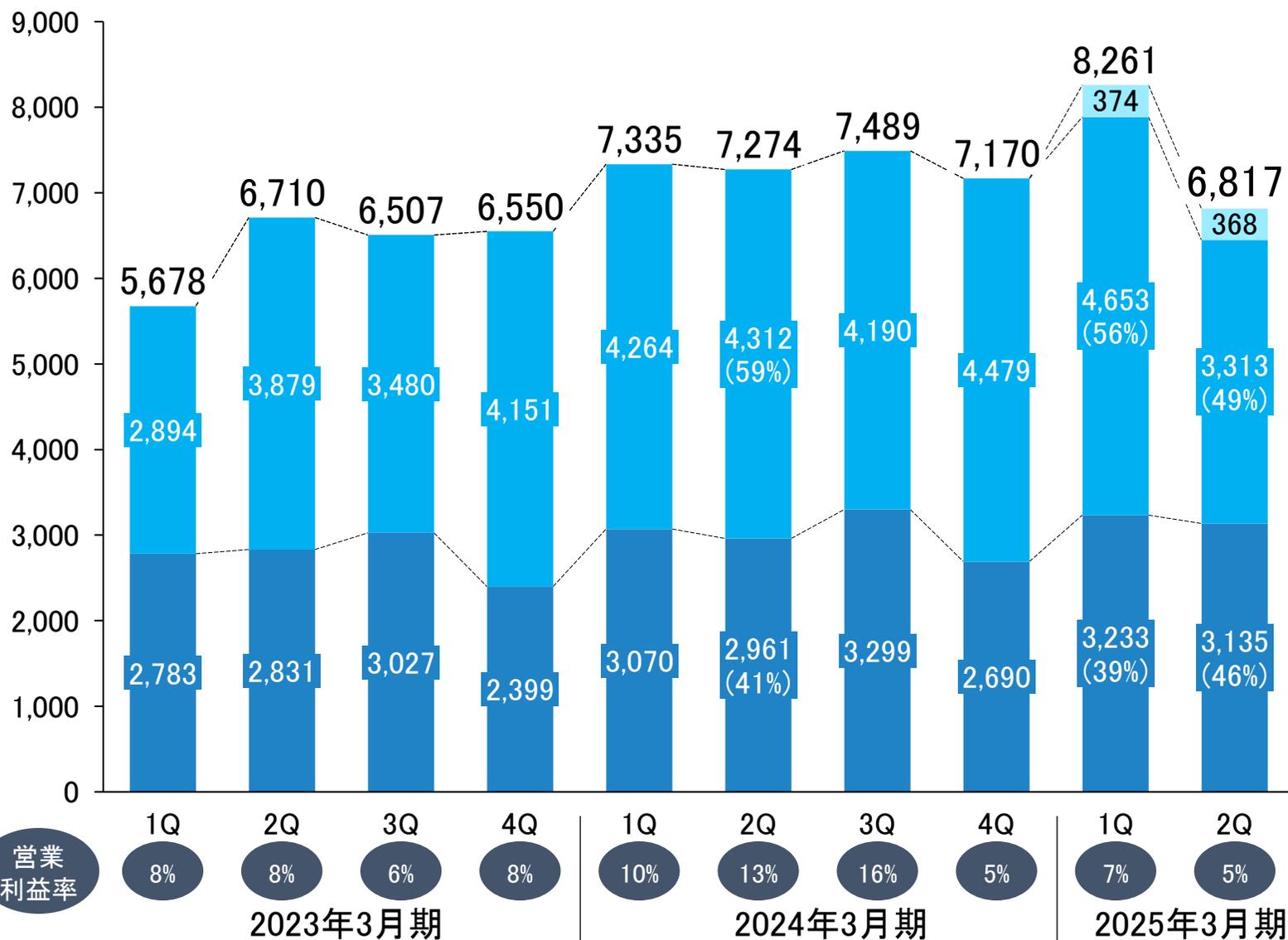
医療・医薬品事業

医療・医薬品事業 用語説明

用語	内容
長期収載品	新薬として発売された後に特許期間もしくは再審査期間が終了し、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の販売が可能となっている先発品
CDMO	医薬品製造及び医薬品製剤開発を受託する機関 (Contract Development Manufacturing Organization)
GMP	医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準 (Good Manufacturing Practice)

医療・医薬品事業 会社別売上高

単位：百万円



前年同期比 前四半期比
累計

リック* (歯科事業)	+742	△6 (△2%)
太陽 ファルマ テック (製造受託)	△609 (△7%)	△1,339 (△29%)
太陽 ファルマ (製造販売)	+335 (+6%)	△98 (△3%)

* 当第1四半期より連結子会社化

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

